中信证券股份有限公司

关于

成都市汉桐集成技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年六月

目 录

目 录 1
第一节 发行人基本情况 3
一、发行人基本信息 3
二、主营业务 3
三、核心技术 3
四、研发水平 4
五、主要经营和财务数据及财务指标 7
六、发行人面临的主要风险 8
第二节 本次证券发行情况 12
一、本次发行情况 12
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 12
三、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 13
四、保荐人内部审核程序和内核意见 14
第三节 保荐人承诺事项 16
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐意见 17
一、保荐意见 17
二、本次发行履行了必要的决策程序 17
三、保荐人对发行人是否符合创业板定位和国家产业政策的专业判断 17
四、发行人符合《创业板上市规则》规定的上市条件 18
第五节 上市后持续督导工作安排 20

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称：成都市汉桐集成技术股份有限公司

英文名称：Chengdu Hantong Integrated Technology Co., Ltd.

有限公司成立日期：2015 年 3 月 20 日

股份公司成立日期：2022 年 11 月 23 日

注册资本：3,543.4984 万元人民币

法定代表人：罗辑

住所：成都高新区科园南路 88 号 12 栋 101、102 号

邮政编码：610093

电话：028-61647058

传真：028-61647026

互联网地址：http://www.chinarint.com

电子邮箱：yezhao@chinarint.com

信息披露部门：董事会办公室

信息披露负责人：叶钊

二、主营业务

公司是一家专注于高可靠军用集成电路的研发、设计、封装及销售的国家级高新技术企业，主要产品包括军用光电耦合器模块和芯片及军用高可靠军用集成电路封装代工服务。自成立以来公司深耕军用集成电路市场，通过不断研发创新，公司已拥有国内领先的军用光耦芯片设计及应用平台和高可靠陶瓷封装设计及制造平台，具备完全自主可控的光电耦合器生产能力和高可靠稳定军用集成电路陶瓷封装能力。

自 2015 年设立以来，公司以军用光耦芯片设计与应用及军用集成电路封装产品为核心业务，依托自身在芯片开发及应用和特种封装领域深厚的技术和工艺积累，围绕新

国际环境下国防军工领域客户的需求，不断丰富扩展自身产品和服务，为客户提供了自主可控、技术领先、性能可靠稳定的全国产化光耦产品及质量高可靠的特种封装产品。目前，公司产品主要应用于航空、航天、兵器、电子、船舶等高精尖领域，向机载、弹载、舰载等武器装备进行配套，并满足了以上领域对配套产品全温区、长寿命、耐腐蚀、抗冲击等高可靠性要求。

在光电耦合器领域，目前公司产品主要包括晶体管输出型光电耦合器、功率型光电耦合器及高速光耦等，产品核心电子元器件光耦芯片为公司自主研发设计，公司光电耦合器产品主要应用于航空、航天、兵器、电子、船舶等军用高精尖领域，涉及众多武器装备型号。

在高可靠军用集成电路封装领域，公司拥有成熟的特种集成电路陶瓷封装产线，目前封装的主要形式为 CSOP（陶瓷小外形外壳封装）、CFP（陶瓷扁平封装）、CSOJ（陶瓷 J 型引脚小外形外壳封装）、CLGA（陶瓷栅格阵列封装）等封装形式，产品一筛平均合格率在 95%以上，处于行业领先水平。经过多年经营，公司积累了丰富的高可靠军用集成电路封装技术，在特种集成电路封装全流程的各节点中拥有自主知识产权技术，生产效率较高，相较于市场同类供应商，公司交付周期短，且产品具有一定成本优势。

三、核心技术

通过多年的研发和技术积累，公司形成了多项自主研发的核心技术，并已全面应用在各主要产品的设计生产当中，实现了科技成果的有效转化。截至本上市保荐书签署日，公司核心技术权属清晰，不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷，具体情况如下表所示：

序号	核心技术名称	技术简介	核心技术的先进性及具体表征	对应的主要专利、软著情况	产品应用	技术来源
1	单片集成电路特种封装的自动点胶贴片技术	进行适应批产的特殊管壳点胶贴片工艺改进，提升批产能力情况下，提高了该工艺控制水平和质量保证能力。	特殊管壳也适合大批量生产，并增加了过程质量控制，保证特种封装在全自动点胶贴片工序的生产质量要求。	ZL201820570270.X ZL202121568817.0 ZL202120938107.6 ZL201820571242.X ZL201820570271.4	单片集成电路特种封装	自有技术
2	单片集成电路特种封装的自动键合技	解决特种封装管壳在全自动键合机上的大批量，连续生产，提升生产效率问题。	将自主设计的特种工装与全自动设备结合，改造了全自动设备能力，适合特殊封装全自动键	ZL202120215351.X ZL202120403614.X	单片集成电路特种封装	自有技术

序号	核心技术名称	技术简介	核心技术的先进性及具体表征	对应的主要专利、软著情况	产品应用	技术来源
	术		合批产要求。			
3	单片集成电路特种封装的自动封帽技术	增加预处理工艺，提升生产效率和质量，减小原工艺难度。	增加自己开发的焊接设备和预处理工艺，保证了封装的封帽质量并能够大批量生产。生产效率提升 60%。	ZL201821258501.X	单片集成电路特种封装	自有技术
4	模块特种封装的自动点胶贴片技术	解决多部件及结构件分离加工的低效率问题，优化流程，提升了模块的封装效率与质量一致性。	通过自己设计的特殊装置和设备，整合特殊封装中多个分离部件与架构件，统一一次性完成点胶贴片工艺，并设计检测装置进行质量检测，提升质量一致性及批产效率。	ZL202121568696.X ZL202121865690.9 ZL201820814580.1 ZL202120084854.8	全系列光电耦合器及模块	自有技术
5	模块特种封装的自动键合技术	整合多品种特种封装复杂模块电路在全自动机上的要求，满足不同复杂电路全自动键合需要。	设计开发了兼容复杂外形尺寸封装的多用途模具，解决单品种超过 1000 线键合以及内部较大高度差的复杂模块高精度键合生产需要。	ZL202121568698.9 ZL201820563454.3 ZL201820601389.9	全系列光电耦合器及模块	自有技术
6	模块特种封装的自动封帽技术	针对光耦产品设计特殊工装，接口封帽设备，解决人工传递及批产管理问题。	通过技术改进，减少人为操作，提升质量一致性。	ZL201821258501.X ZL201820562699.4 ZL201820601388.4	全系列光电耦合器及模块	自有技术
7	特种封装的封装载盘技术	对多部件及结构件产品封装的产线传递、生产机器接口等进行特殊工装设计，满足产线管理及投产需要。	通过技术改进，设计了特殊的不同类型产品的装载与传递以及与机器生产的接口装置，提高生产在线管理及产线流转能力。	ZL201820563452.4 ZL201820561850.2	全系列光电耦合器及特种封装	自有技术
8	微小型全瓷光耦技术	主要解决军用电子元器件体积小，轻量化	与传统技术相比，布版面积解决接近 80%，体积最小可达到 2mm×2mm×1mm，重量小于 3 克	发明专利申请号：202210678445.X	全系列光电耦合器	自有技术
9	光电耦合器结构技术	通过结构技术的创新，降低生产工艺难度，减少生产工序，提升生产效率。	通过本技术，可有效减少键合线数。	ZL201820387264.0	全系列光电耦合器	自有技术
10	高反压光电耦合技术	在前后级隔离应用中，由于前级信号可能存在幅度较高的干扰源，通过提升输入级的反向电压可有效提升反向抗干扰能力	进口友商最大输入级反向电压一般为 5-10V，通过该技术，输入级反向电压可达到 40V	非专利核心技术	全系列光电耦合器	自有技术
11	增益一致	在光耦应用中，电流传输	目前进口友商增益范围	非专利核	光耦	自有

序号	核心技术名称	技术简介	核心技术的先进性及具体表征	对应的主要专利、软著情况	产品应用	技术来源
	性控制技术	比是一个核心指标，一般均要求电流传输比在同型号产品中尽量一致，电流传输比与结构对位关系与芯片本身的放大倍数紧密相关。本技术能使输入信号的动态范围变化内放大器的增益波动范围变小	一般超过±20%，采用本技术可使增益控制在±10%以内	心技术	芯片	技术
12	低压锁定保护技术	当芯片检测到外部供电电源电压过低时，为避免后级电路受损，自动关闭输出	低压保护典型值为12V，与进口友商相当	非专利核心技术	光耦芯片	自有技术
13	故障保护技术	当芯片检测到外围电路故障，自动关闭输出电路以保护后级电路进一步受损	当故障检测与基准电压超过 7V 时，启动故障保护，与进口友商相当	非专利核心技术	光耦芯片	自有技术
14	低延时、高传输速率技术	保证高速信号的传输隔离	延时时间小于 20ns，传输速率 50M，与进口友商相当	非专利核心技术	光耦芯片	自有技术

四、研发水平

公司始终坚持以客户需求为导向，将前沿技术理论与客户个性化需求相结合，坚定不移地推进产品领先、技术领先的发展战略，不断优化体制，健全机制，在加大投入的同时，强化研发团队建设，构建了产品应用一代、研发一代、储备一代的“三位一体”自主创新体系，不断提升公司核心竞争力。

公司系国家级高新技术企业。经过多年的研发投入和技术积累，已取得的各项资质荣誉和技术成果充分体现了公司的技术水平与科研实力，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人已取得实用新型专利 33 项。

截至本上市保荐书签署日，公司建立了完善的研发体系，设置了科技委、研发部、工艺部等多个研发部门。截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发人员合计 15 名。

公司作为研发驱动的高科技企业，保持持续、大量的研发投入。报告期各期，公司研发费用分别为 255.14 万元、588.48 万元和 3,435.35 万元，占营业收入比例分别为 9.38%、5.36%和 15.57%。

五、主要经营和财务数据及财务指标

（一）主要经营情况

报告期内，发行人主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

业务类型		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
光电耦合器	晶体管输出型光耦	5,317.95	24.24%	1,338.19	12.29%	807.92	30.05%
	功率型光耦	1,873.54	8.54%	1,706.93	15.67%	303.72	11.30%
	高速光耦	1,489.49	6.79%	662.13	6.08%	165.98	6.17%
	光耦芯片	909.02	4.14%	722.88	6.64%	147.35	5.48%
	小计	9,590.01	43.71%	4,430.12	40.68%	1,424.96	53.00%
高可靠军用集成电路封装	单片陶瓷封装	11,574.13	52.75%	6,219.73	57.12%	1,205.49	44.83%
	模块陶瓷封装	776.24	3.54%	239.97	2.20%	58.33	2.17%
	小计	12,350.37	56.29%	6,459.69	59.32%	1,263.82	47.00%
合计		**21,940.37**	**100.00%**	**10,889.82**	**100.00%**	**2,688.78**	**100.00%**

（二）主要财务数据及财务指标

报告期内，发行人主要财务数据及财务指标如下：

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年	2021 年 12 月 31 日/2021 年	2020 年 12 月 31 日/2020 年
资产总额（万元）	31,198.11	12,714.92	3,496.87
归属于母公司所有者权益（万元）	24,016.64	9,589.31	2,710.11
资产负债率（%）	23.02	24.58	22.50
营业收入（万元）	22,068.95	10,972.68	2,720.14
净利润（万元）	8,418.90	6,212.20	394.67
归属于母公司所有者的净利润（万元）	8,418.90	6,212.20	394.67
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,987.38	6,140.52	1,206.49
基本每股收益（元/股）	2.53	不适用	不适用
稀释每股收益（元/股）	2.53	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	61.78	94.41	23.07
经营活动产生的现金流量净额（万元）	7,205.78	3,218.67	-163.74

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年	2021 年 12 月 31 日/2021 年	2020 年 12 月 31 日/2020 年
现金分红（万元）	6,666.67	833.00	-
研发投入占营业收入的比例（%）	15.57	5.36	9.38

六、发行人面临的主要风险

（一）发行人相关风险

1、较高毛利率不能持续的风险

公司专注于高可靠军用集成电路的研发、设计、封装及销售，报告期主营业务毛利率分别为 77.47%、81.95%和 83.65%，处于较高水平。受市场竞争、原材料价格波动、下游客户产品价格情况等因素影响，如果公司未来不能持续保持和提高市场竞争力，或者原材料的价格大幅上升且不能有效传递至下游客户，则可能导致公司毛利率水平下滑，主要产品市场份额下降，从而导致公司经营业绩下滑的风险。

2、客户集中度较高风险

2020 年度至 2022 年度，公司各年度合并口径前五大客户的收入占营业收入的比重分别为 94.82%、94.88%和 93.35%，客户集中度较高。随着国际形势的变化，我国国防和军队改革步伐的加快，公司客户对产品和服务质量、交付速度方面的要求逐步提高。如果公司与主要客户的业务合作中出现产品质量、延期交付等方面的问题，将不利于公司与主要客户的持续合作，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

此外，公司对第一大客户国微电子的收入占营业收入的比重分别为 69.02%、60.83%和 63.89%。由于半导体行业整体仍处于去库存的大周期中，如果国微电子后续受到半导体周期性影响较大，有可能会降低对公司封装服务的采购，从而对公司业绩造成不利影响。

3、军工资质延续的风险

我国军品生产及销售存在严格的资质审核制度和市场准入制度，武器装备需纳入军方型号管理，由军方组织项目综合论证，在军方的控制下进行型号研制和设计定型，整个项目程序严格且时间较长。截至本上市保荐书签署日，公司拥有从事军品业务所需的业务资质，但仍存在丧失现有业务资质或不能及时获取相关资质的风险，对公司未来的生产经营产生不利影响。

4、产品创新风险

作为知识技术和人才密集型企业，公司产品研发和技术储备依赖于对行业的认知、经验的积累和对人才的培养。同时，为保证公司产品的技术符合军用市场不断变化的需求，公司需要对新技术和新产品持续开展研发创新，从而保持技术的先进性和产品的竞争力。如果公司不能把握技术、产品和市场需求的发展趋势或不能保持持续的创新能力，或将导致新产品不能适应市场的需求，进而对公司未来的业务发展和竞争力造成不利影响。

5、核心技术人才流失风险

公司所处行业是一个典型的技术密集型行业，核心技术优势及可持续的研发创新能力是公司的核心竞争力，优秀的技术人才是影响公司未来发展的关键因素。伴随军用集成电路行业技术的逐步升级和竞争的不断加剧，行业内各企业对专业技术人才的需求愈发增大，如果未来公司不能建立健全完善的技术人才管理体制，持续引进、培养和激励核心技术人才，将面临人才流失的风险，对生产经营造成不利影响。

6、业务规模扩张带来的管理风险

最近三年公司营业收入的年均复合增长率为 184.84%，处于高速发展阶段。随着公司研发能力的不断提升、营销体系的不断扩大以及本次募投项目的实施落地，预计公司的业务规模仍将保持高速增长。公司资产、收入、员工、客户及市场区域等规模扩张后，对公司的经营管理能力与水平提出了更高的要求。若公司不能及时根据业务规模情况持续改进或重构经营管理方式，致使企业管理能力与业务规模扩张无法匹配，甚至出现制约业务规模扩张的情形，将会对公司的生产经营产生重大不利影响。

7、税收优惠政策变化的风险

根据《高新技术企业认定管理办法》，公司被认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率。若未来公司高新技术企业资格到期后未能通过重新认定，则无法继续取得新的高新技术企业证书及享受企业所得税优惠政策，将对公司经营业绩产生不利影响。

8、应收账款余额增加导致的坏账风险

随着公司经营规模扩大，公司应收账款规模不断增加。报告期各期末，公司应收账

款净额分别为 552.76 万元、1,194.07 万元和 4,673.89 万元，增长较快。虽然公司下游客户主要为军工集团下属企业及科研院所，信用状况良好，且公司已根据企业会计准则的规定对应收账款计提了充分的坏账准备，但公司应收账款规模随营业收入增长而增加，如果宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临应收账款回收困难从而导致坏账增加的风险。

9、知识产权或技术泄密的风险

公司主要从事高可靠军用集成电路的研发、设计、封装及销售，所处行业属于知识、技术密集型行业。公司主营产品所涉及的主要核心技术已形成了具有自主知识产权的专利和计算机软件著作权，同时公司采取与部分员工签订保密协议等多种手段，以保护公司的知识产权与技术秘密。报告期内公司未出现过知识产权或技术秘密泄密的情形。但若将来公司不能有效保障核心技术涉及的知识产权或技术秘密，公司的竞争优势可能会遭到削弱，从而可能对公司的经营业绩造成一定的影响。

（二）行业风险

1、宏观环境变化风险

报告期内，公司收入来自于国内各大军工集团及其下属单位、科研院所和大型民营军工集团，均为军品业务。军工作为特殊的经济领域，主要受国际环境、地缘政治、国家安全形势、国防发展水平等多种因素影响。若未来国际形势出现重大变化，导致国家削减国防支出，使得国防军工用户对公司产品和服务的需求数量产生波动，军品订单减少，将对公司的盈利能力产生不利影响。

2、行业管理体制变动引起的风险

我国国防军工产业的参与者以大型国有军工集团为主，随着国家加速推进国防军工企业改制，出台政策鼓励和引导民营企业参与军品科研生产任务的竞争，越来越多民营企业参与到我国军工产业之中，已成为其中重要的组成部分。公司所处业务领域目前受到国家产业政策的鼓励和支持，但若未来国家军工管理体制、市场进入条件等发生变化，或将使民营军工企业的经营环境恶化，进而对公司未来的生产经营和经营业绩产生一定影响。

3、国家秘密泄密的风险

公司部分信息涉及国家秘密，公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密。公司对相关信息的脱密处理程序及其经过脱密处理后披露的信息合法合规。但不排除发生意外情况导致有关国家秘密泄露、导致公司丧失保密资质、无法继续开展涉密业务，进而对公司生产经营产生不利影响。

（三）其他风险

1、发行失败风险

本次发行的结果将受到证券市场整体情况、公司经营业绩、公司发展前景及投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。公司存在发行认购不足等未能达到上市条件的情形而导致发行失败的风险。

2、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目的建设计划能否如期完成、项目的实施过程与实施效果、未来的市场环境等存在一定的不确定性。如果市场环境、技术、公司经营状况等方面发生重大不利变化，使得募集资金投资项目不能如期达产，达产后不能产生预期的经济效益，或投资项目新增产能难以消化，都将对公司经营业绩带来一定的不利影响。

3、即期回报被摊薄与净资产收益率下降的风险

本次发行后，公司资本实力将得到增强，净资产大幅增加。但是由于募集资金投资项目需要一定的投入周期，在短期内难以完全产生效益。因此，公司在发行当年每股收益及净资产收益率受股本摊薄影响可能出现下降，从而导致公司即期回报被摊薄。

第二节 本次证券发行情况

一、本次发行情况

股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

每股面值：1.00 元人民币。

发行股数：不超过 1,181.3333 万股（行使超额配售权之前，且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准）

占发行后总股本的比例：不低于 25%

发行方式：本次发行将采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或者中国证监会、深圳证券交易所等证券监管部门认可的其他发行方式

发行对象：符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在深交所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）

承销方式：余额包销

二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指定赵亮、马峥作为汉桐集成本次发行的保荐代表人；指定王祝遥为项目协办人；指定陈灏蓝、余梓轩、蒋钰诚、朱子豪为其他项目组成员。

（一）保荐代表人

赵亮，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会董事总经理，曾负责或参与了东软载波、天和防务、三诺生物、奥瑞金、白云电器、朗新科技、彩讯科技、睿创微纳、左江科技、斯达半导、宏英智能等 IPO 项目，歌尔声学、天康生物、全聚德等再融资项目，东软载波、新研股份等重大资产重组项目的工作。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

马峥，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监，曾负责或参与了彩讯科技、斯达半导体、奥瑞金、成都深冷、震有科技、楚天龙、国光电气、佳缘科技、

振华风光、臻镭科技等多家公司的 A 股 IPO 工作，负责了华扬联众、斯达半导体等上市公司的非公开发行股票项目，负责了神州泰岳、东杰智能、华扬联众、金宇车城等上市公司的重大资产重组项目，主导完成了对广州优蜜、墨麟股份、互爱互动等信息传媒行业企业投资及资本运作工作。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

王祝遥，男，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级经理，参与了佳缘科技、振华风光、星际荣耀等 A 股 IPO 项目。

（三）项目组其他成员

陈灏蓝，男，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级副总裁，曾负责或参与了国光电气、佳缘科技、彩讯科技、斯达半导、澜起科技、睿创微纳、泰坦科技、臻镭科技等 A 股 IPO 项目，重庆钢铁重大资产重组项目、苏宁院线跨境并购项目、斯达半导再融资等资本运作项目。

余梓轩，男，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组副总裁，曾负责或参与了斯达半导 IPO 项目、震有科技 IPO 项目、楚天龙 IPO 项目、中微半导 IPO 项目、米飞泰克 IPO 项目、瀛通通讯可转债、斯达半导非公开、某重大资产重组等项目。

蒋钰诚，男，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级经理，曾参与了国光电气 IPO、振华风光 IPO、平安电工 IPO、星际荣耀 IPO 等项目。

朱子豪，男，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级经理，曾参与了万物云 H 股 IPO 项目、米飞泰克 IPO 项目和某再融资等项目。

三、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人或保荐人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况，与公司也不存在其他权益关系。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份的情况，亦不存在在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

四、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）内核程序

中信证券设内核部，负责本保荐人投资银行类项目的内核工作。本保荐人内部审核具体程序如下：

首先，由内核部按照项目所处阶段及项目组的预约对项目进行现场审核。内核部在受理申请文件之后，由两名专职审核人员分别从法律和财务的角度对项目申请文件进行初审，同时内核部还外聘律师及会计师分别从各自的专业角度对项目申请文件进行审核。审核人员将依据初审情况和外聘律师及会计师的意见向项目组出具审核反馈意见。

其次，内核部将根据项目进度召集和主持内核会议审议项目发行申报申请，审核人

员将把项目审核过程中发现的主要问题形成书面报告在内核会上报告给参会委员；同时保荐代表人和项目组需要对问题及其解决措施或落实情况向委员进行解释和说明。在对主要问题进行充分讨论的基础上，由内核委员投票表决决定项目发行申报申请是否通过内核委员会的审核。内核会后，内核部将向项目组出具综合内核会各位委员的意见形成的内核会反馈意见，并由项目组进行答复和落实。

最后，内核部还将对持续督导期间项目组报送的相关文件进行审核，并关注发行人在持续督导期间出现的重大异常情况。

（二）内部审核意见

2023 年 5 月 18 日，中信证券召开了汉桐集成 IPO 项目内核会，对该项目申请进行了讨论，经全体参会内核委员投票表决，该项目通过了中信证券内核委员会的审议，同意将汉桐集成的申请文件上报监管机构审核。

第三节 保荐人承诺事项

一、保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。本保荐人同意推荐成都市汉桐集成技术股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。

二、保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。

三、保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

五、保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。

六、保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

七、保荐人保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。

九、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，并接受深圳证券交易所的自律监管。

十、若因保荐人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐意见

一、保荐意见

本保荐人根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《创业板上市规则》《保荐人尽职调查工作准则》等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为发行人具备《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《创业板上市规则》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件。发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，本保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在创业板上市予以保荐。

二、本次发行履行了必要的决策程序

（一）董事会

2023 年 5 月 12 日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（二）股东大会

2023 年 5 月 29 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，全体股东出席会议，审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

经核查，本保荐人认为，发行人已就本次首次公开发行股票并在创业板上市履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及深圳证券交易所的有关业务规则的决策程序。

三、保荐人对发行人是否符合创业板定位和国家产业政策的专业判断

保荐人通过对公司主营业务和所处行业发展趋势、生产经营和财务状况、研发投入和核心技术等方面进行核查，并对以下方面进行了重点分析与核查：①公司的技术创新

性及其表征；②公司属于现代产业体系及其表征；③公司的成长性及其表征；④公司符合创业板行业领域及其依据；⑤公司符合创业板定位相关指标及其依据；⑥公司符合国家产业政策的情况。

经核查，保荐人认为：公司以技术创新驱动业务不断发展，所处行业属于技术创新驱动型行业，属于现代产业体系。公司属于成长型企业，报告期内业绩水平不断提升，未来成长空间良好。此外，公司主营业务与新技术、新产业、新业态的深度融合，具备较强的项目实施能力和科技创新能力，公司的商业模式稳定，市场形象良好，成长性较强，符合相关法律法规中对创业板定位的要求及相关指标，符合国家产业政策。

四、发行人符合《创业板上市规则》规定的上市条件

本保荐人依据《创业板上市规则》相关规定，对发行人是否符合《创业板上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：

汉桐集成上市符合《公司法》《证券法》和《创业板上市规则》规定的上市条件：

（一）符合中国证监会规定的创业板发行条件。

1、发行人已依据《公司法》等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会，在董事会下设置了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并建立了独立董事工作制度、董事会秘书工作细则，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度，董事、监事和高级管理人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构。

2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2023]8053号），发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度营业收入分别为 2,720.14 万元、10,972.68 万元、22,068.95 万元；归属于普通股股东的净利润分别为 394.67 万元、6,212.20 万元和 8,418.90 万元。发行人财务状况良好，营业收入和净利润表现出了较好的成长性，具有持续盈利能力。

3、发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性，最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为。

4、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营能力。

5、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

（二）本次发行前公司总股本为 3,543.4984 万股，本次拟发行普通股不超过 1,181.3333 万股，本次发行后公司股本总额不低于人民币 3,000 万元。

（三）本次拟发行普通股不超过 1,181.3333 万股，本次公开发行的股份数不少于本次发行上市后发行人股份总数的 25%。

（四）发行人选择《上市规则》第 2.1.2 条第一项标准，即：“（一）最近 2 年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。”

经核查，发行人最近两年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后的孰低者）分别为 6,140.52 万元及 8,418.90 万元，累计达到 14,559.42 万元。发行人符合所选上市标准。

（五）发行人选择《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第三条第一项标准，即：“最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年研发投入金额不低于 1,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%”

报告期内，发行人研发投入及营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
研发费用	3,435.35	588.48	255.14
营业收入	22,068.95	10,972.68	2,720.14

经核查，如上表所示，发行人 2020 年度至 2022 年度研发费用复合增长率为 266.94%，2022 年度研发费用为 3,435.35 万元；发行人营业收入快速增长，2020 年度至 2022 年度复合增长率为 184.84%，满足上述上市标准中“最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年研发投入金额不低于 1,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%”的要求。因此，发行人满足所选择的上市标准。

第五节 上市后持续督导工作安排

事项	工作安排
（一）持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐协议》约定确保保荐人对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易本保荐人将按照公平、独立的原则发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、深圳证券交易所报告；按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明
（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保荐工作，为保荐人的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据
（四）其他安排	无

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都市汉桐集成技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

保荐代表人：

赵 亮

马 峥

项目协办人：

王祝遥

内核负责人：

朱 洁

保荐业务负责人：

马 尧

董事长、法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

2023 年 6 月 21 日